



2021年3月期 本決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2021年4月28日

アジェンダ



決算報告

取締役 佐伯 幸雄

中期経営計画 VISION2025 2022年3月期 業績見込み

代表取締役社長 徳重 敦之



決算報告

取締役 佐伯 幸雄

2021年3月期 決算概況



前期比 増益増収

売上高 5.8% 増

経常利益 29.4% 増

親会社株主に帰属する当期純利益 37.3% 増

通期業績予想比 増益増収

業績概要 前期比

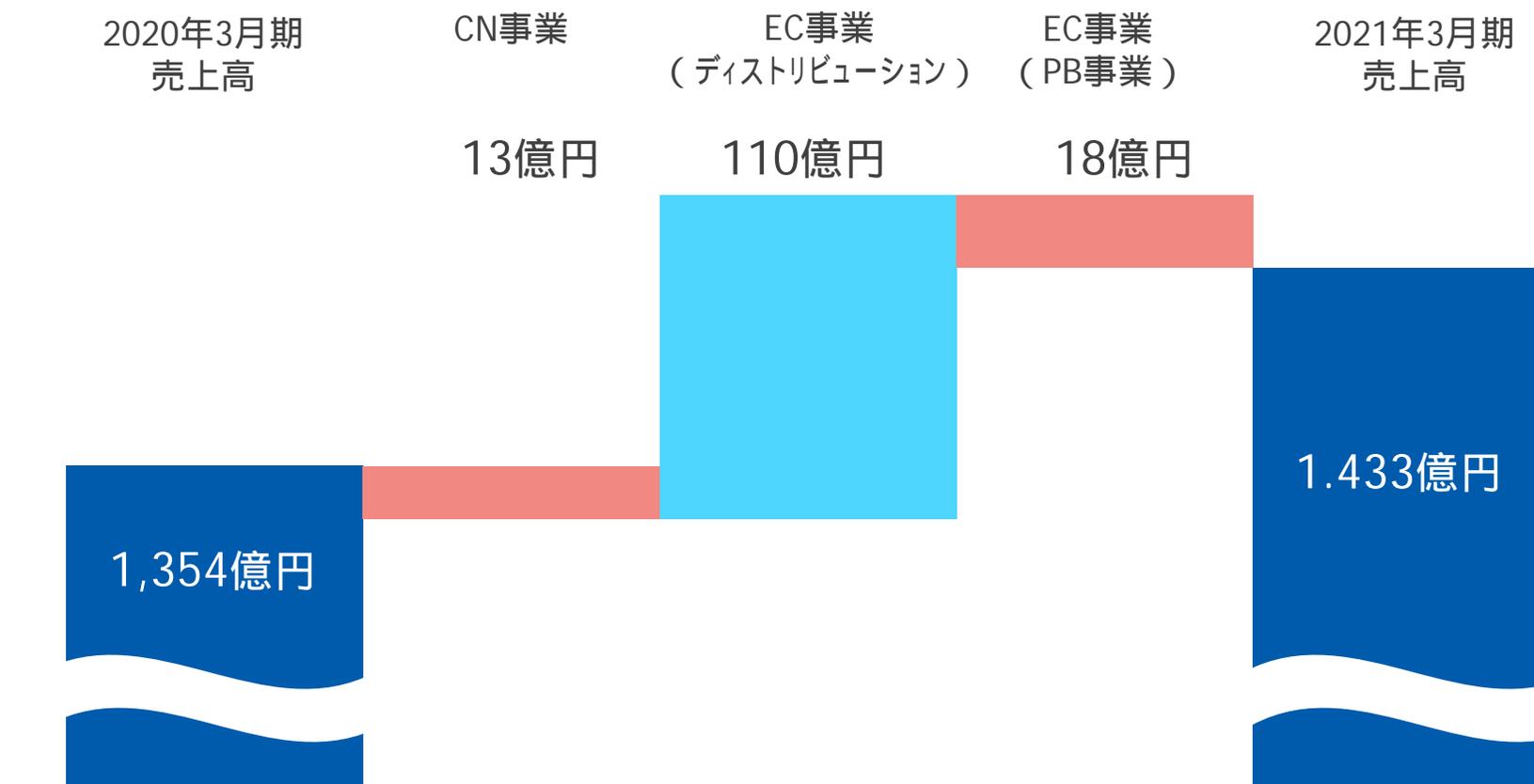


(百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	増減額	2021年3月期 予想
売上高	135,394	143,268	7,873	138,000
売上原価	115,491	122,666	7,174	
売上総利益	19,902	20,601	699	
販管費	16,091	15,981	110	
営業利益	3,810	4,620	810	
営業外収益	164	181	16	
営業外費用	401	176	225	
経常利益	3,573	4,625	1,051	4,100
当期純利益	2,288	3,143	854	2,700
従業員数	1,216名	1,247名	31名	

当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益
東京エレクトロンデバイス

業績概要 売上高 増減



※金額は四捨五入で記載しております

セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。
PB事業とは、プライベートブランド事業の略称であり、従来の呼称である自社ブランド事業を呼称変更しております。
PB事業には、東京エレクトロン デバイス長崎株式会社、株式会社ファーストを含んでおります。

セグメント別 売上高・利益

- CN事業 代理店契約解消に伴い減収 保守・監視サービス伸長により増益
- EC事業 代理店契約解消を 下期から本格化した商権拡大でカバー
1 Qを底に 2 Qから半導体市場回復 3 Q 4 Qは活況

(百万円)

	2020年3月期		2021年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減額	セグメント利益	増減額
コンピュータシステム関連 (CN)事業	25,255	2,701	23,933	1,322	2,834	132
半導体及び電子デバイス (EC)事業	110,138	871	119,334	9,196	1,790	919
合計	135,394	3,573	143,268	7,873	4,625	1,051

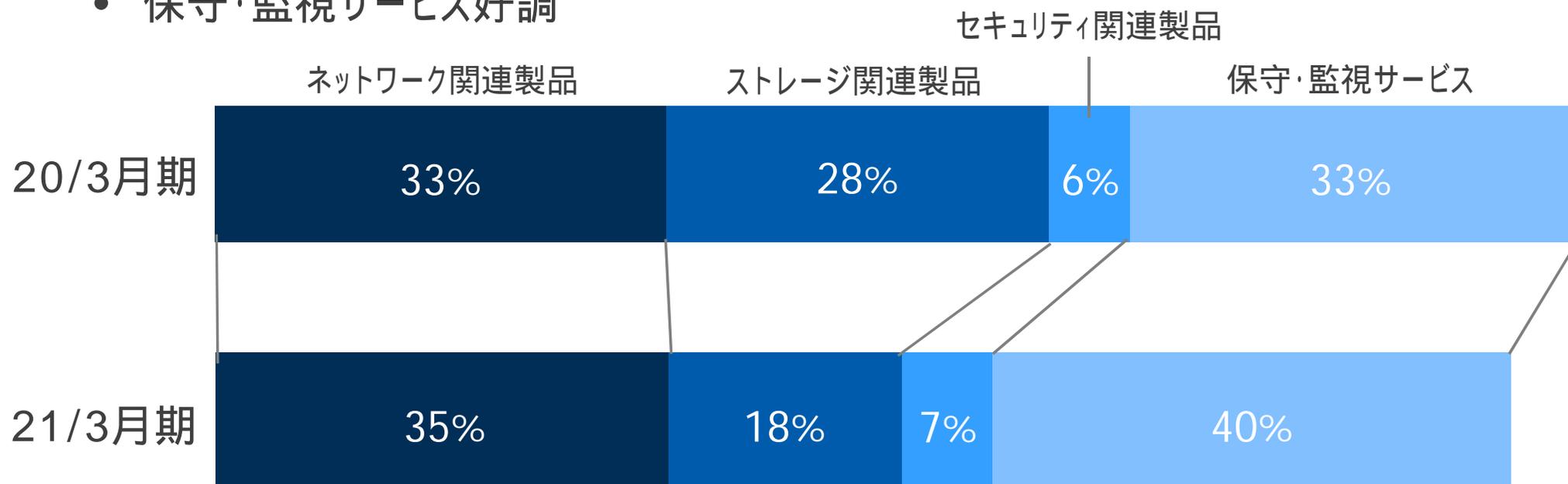
セグメント利益は経常利益
セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。

セグメント情報 CN事業 (1/2)



品目別売上高構成比

- ネットワーク関連製品 データセンター・クラウド事業者向け堅調
- 代理店契約解消により ストレージ関連製品 減少
- 保守・監視サービス好調



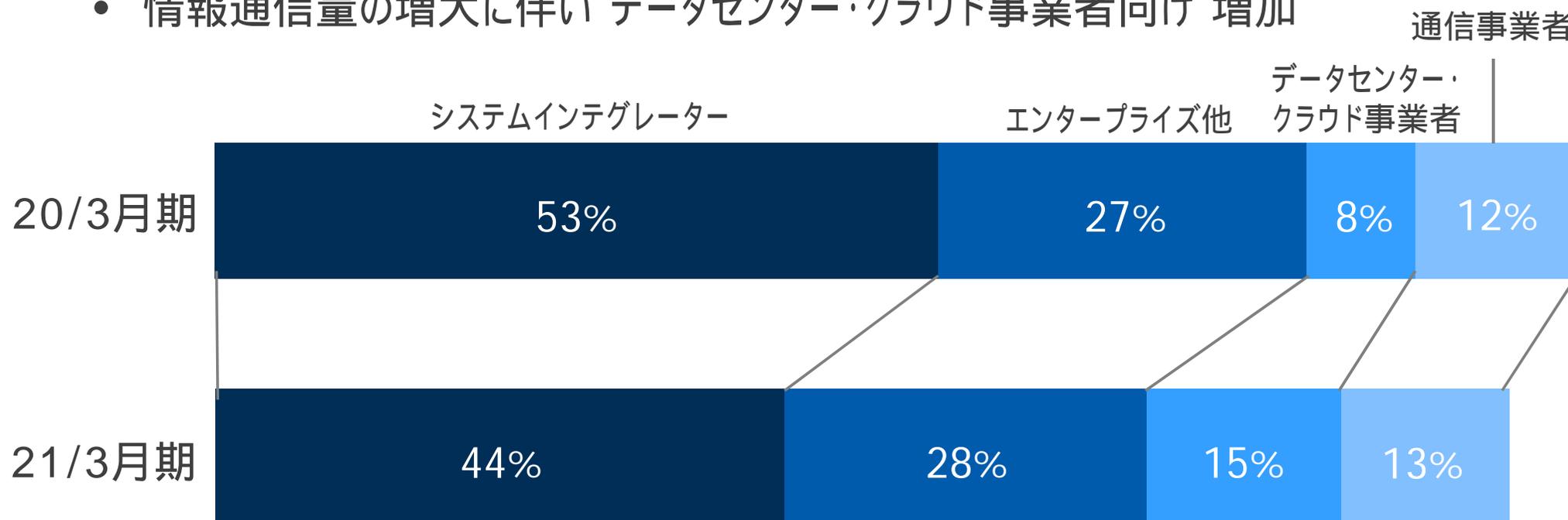
CN事業 品目別売上高構成比は分類を変更しております。
旧分類との対応表を補足資料に掲載しておりますので、ご参照ください。

セグメント情報 CN事業 (2/2)



分野別売上高構成比

- 代理店契約解消により システムインテグレーター向け 減少
- 情報通信量の増大に伴い データセンター・クラウド事業者向け 増加

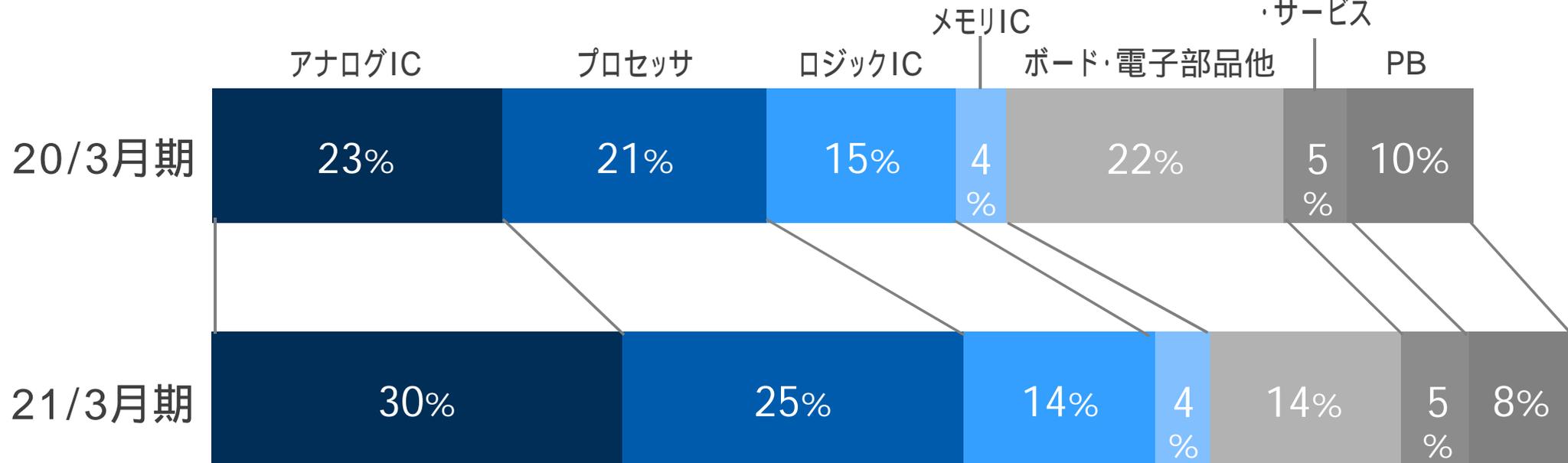


セグメント情報 EC事業 (1/2)



品目別売上高構成比

- アナログIC 産業機器は大幅増加 民生機器 増加 車載減少
- プロセッサ コンピュータ 産業機器 通信基地局 増加
- ボード・電子部品他 代理店契約解消により産業機器 減少



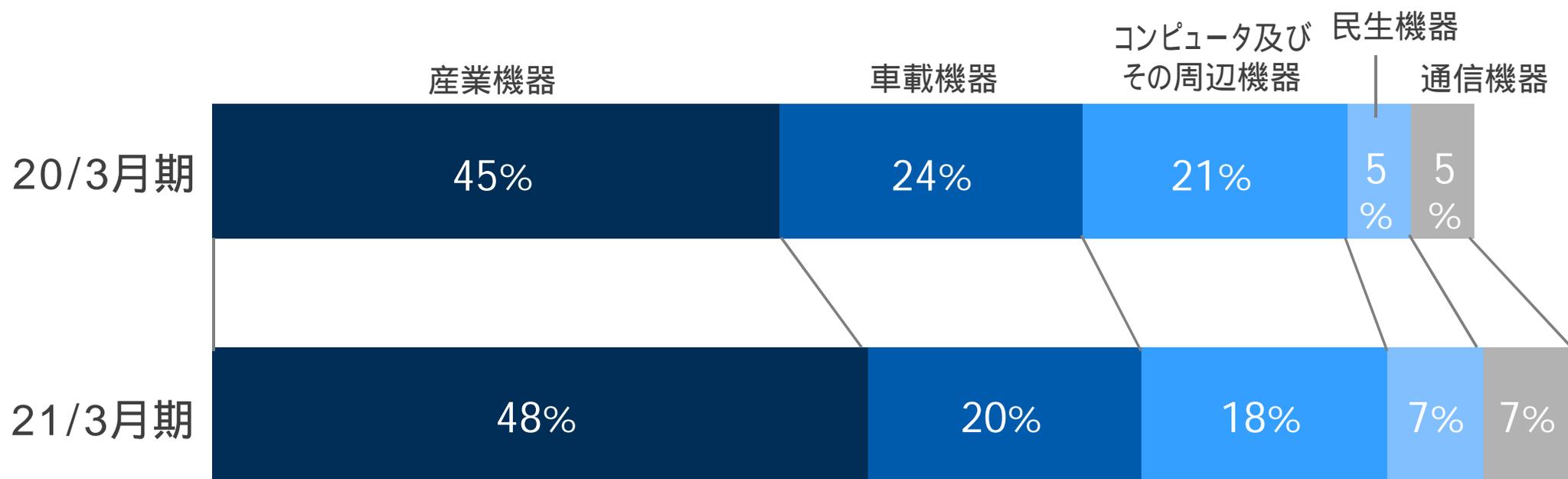
EC事業 品目別売上高構成比は分類を変更しております。
旧分類との対応表を補足資料に掲載しておりますので、ご参照ください。

セグメント情報 EC事業 (2/2)



用途別売上高構成比

- 産業機器 代理店契約解消影響あるも 商権拡大により増加
- 車載機器 コンピュータ及びその周辺機器 新型コロナウイルスの影響で減少



海外連結子会社 売上高 EC事業



- 車載機器 コンピュータ及びその周辺機器 回復
- 民生機器 商権拡大寄与し増加

	2020年3月期	2021年3月期	増減額	増減率
海外連結子会社 売上高(百万円)	28,083	31,324	3,241	11.5%
海外連結子会社 売上高比率	25.5%	26.2%		
海外連結子会社 売上高(M\$)	258	295	36	14.3%
為替レート(円)	108.70	106.10		

PB事業 売上高 EC事業



- インレビウム
- TED長崎
- ファースト

医療機器向け設計・量産受託サービス 低調

半導体製造装置向けは 堅調を維持

検査システム回復も その他製品は新型コロナウイルス影響受け低調

(百万円)

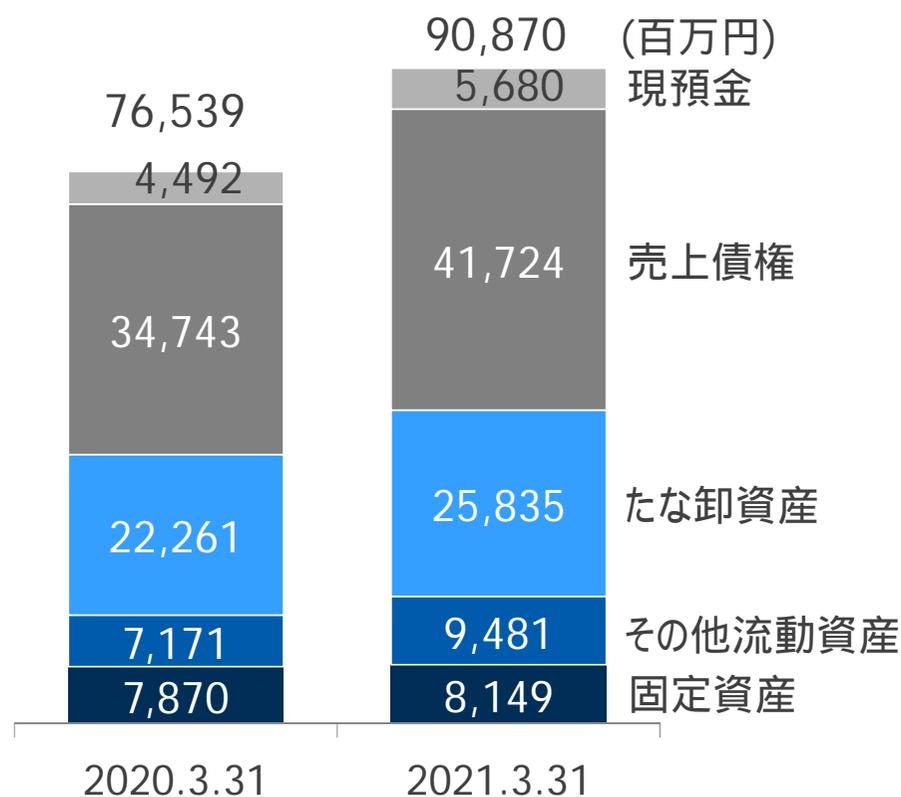
	2020年3月期	2021年3月期	増減額	増減率
PB事業売上高	10,972	9,205	1,767	16.1%
売上高比率	10.0%	7.7%		

貸借対照表



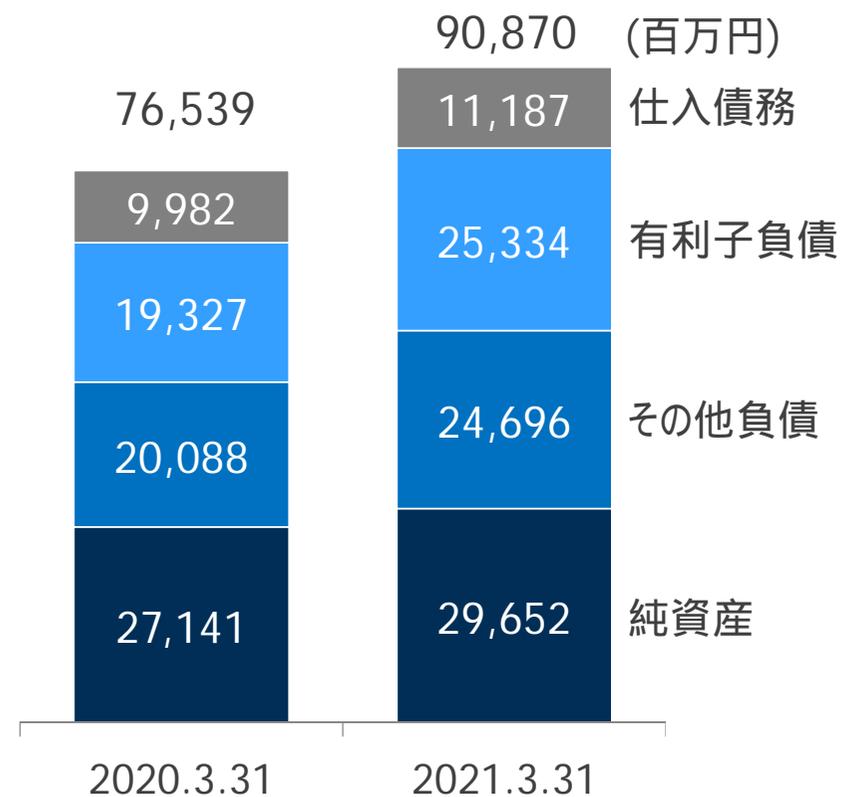
資産

- 売上増加に伴い 売上債権 たな卸資産 増加
- 保守伸長により前払費用増加



負債・純資産

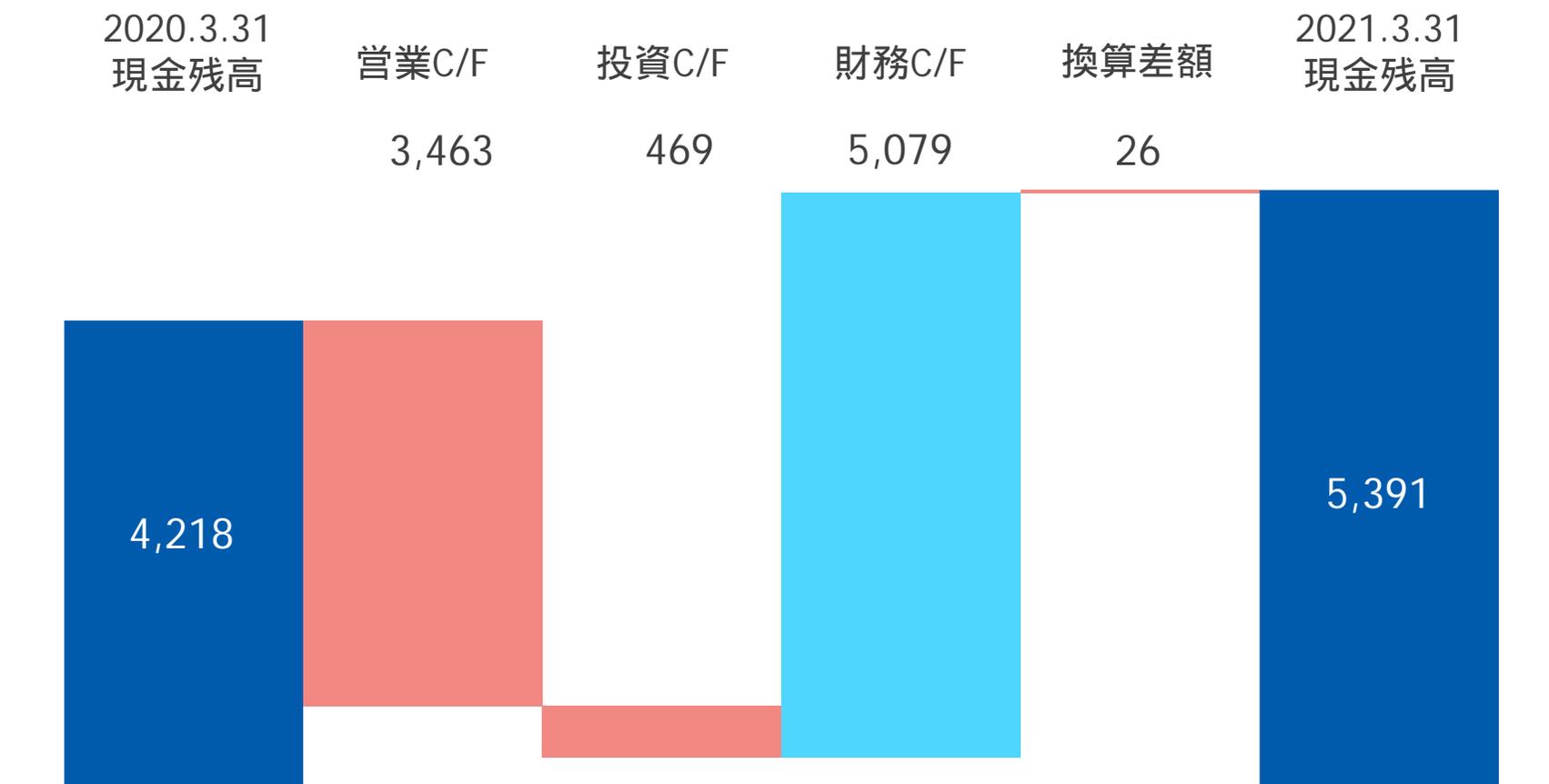
- 売上増加に伴い 仕入債務 有利子負債 増加
- 保守 サブスクリプション伸長により前受金増加



キャッシュ・フロー計算書

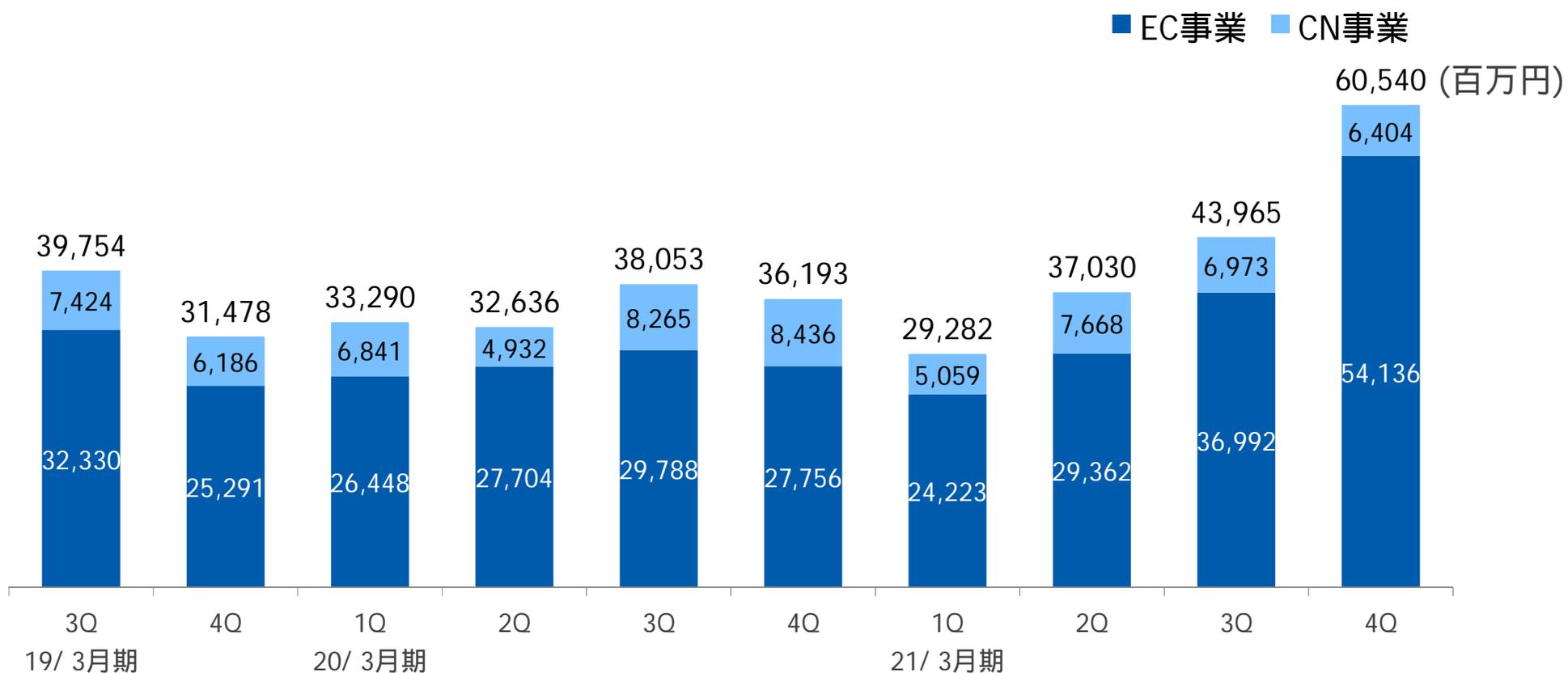


(百万円)



受注高の推移

- CN事業 2Qは研究機関向け大型案件受注 3Q以降は堅調
- EC事業 2021年3月期1Qをボトムに改善 2Q以降 商権拡大寄与 3Q以降は半導体需給逼迫 影響





中期経営計画 VISION2025 2022年3月期 業績見込み

代表取締役社長 徳重 敦之

中期経営計画 VISION2025

VISION2020 実績報告



数値目標：2021年3月期 売上高 2,000億円 経常利益率 3.5%以上 ROE 15.0%

	2015年3月期 実績 (基準年度)	2021年3月期 実績 (最終年度)	対基準年度 成長度
売上高	1,116 億円	1,432 億円	+ 28.3%
(経常利益)	13.5 億円	46.2 億円	3.4 倍
経常利益率	1.2%	3.2%	+ 2.0 ポイント
ROE (株主資本)	3.2%	11.4%	+ 8.2 ポイント
当期純利益	7.1 億円	31.4 億円	4.4 倍
時価総額 (高値)	175 億円	426 億円	2.4 倍
配当金	60 円	125 円	2.1 倍

※金額は
端数切捨てで
記載しております

※当期純利益は
親会社株主に帰属
する当期純利益

2021年3月期 経常利益 当期純利益 時価総額 及び配当金は 上場来レコード

中期経営計画 VISION2025



想定する事業環境

Society 5.0 の到来

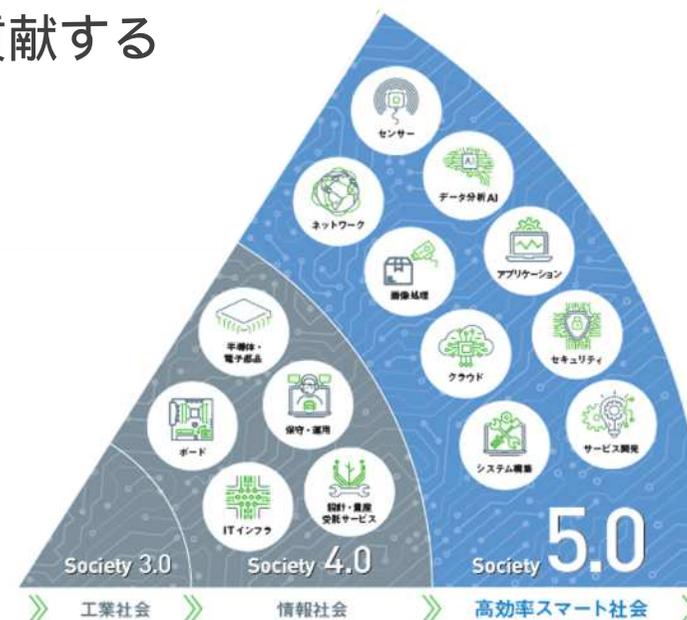
低成長経済下における
高効率スマート社会



当社のMISSION

DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION

デジタルトランスフォーメーションを
実現する製品・サービスを提供し
高効率スマート社会の持続的発展に
貢献する



技術商社機能を持つメーカーへ

進化する技術商社機能

- データ・サービス・ストックビジネスを利益源泉とするビジネスモデル
- メーカー事業の成長に資する顧客基盤の維持・拡大
- 安定的な利益基盤の構築

メーカーとして目指す形

- モノづくりシステムメーカー
- ODMメーカー
- 課題解決型の設計開発部門
- 高効率スマート工場

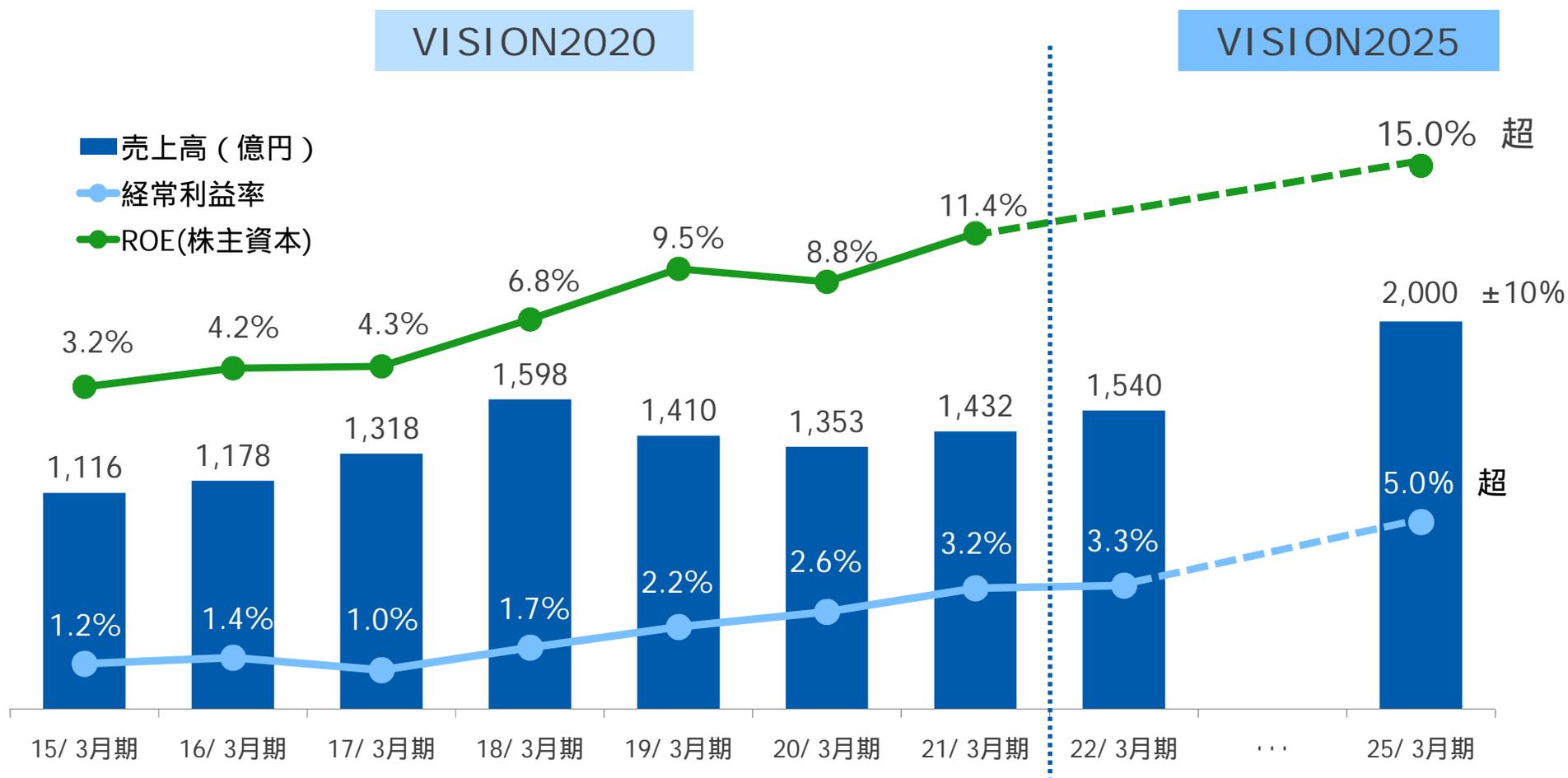
増益増収（増益率 > 増収率）による持続的成長を目指す

2025年3月期

- 売上高 2,000 億円 ±10%
- 経常利益率 > 5 %
- ROE（株主資本） > 15 %

	売上高構成比	経常利益率
CN事業	20 %	> 13 %
EC事業	70 %	> 2 %
PB事業	10 %	> 10 %

中期経営計画 実績と計画



2022年3月期 業績見込み

新会計基準の適用による影響

- 会計ルールの変更に基づく 売上高の減少

TED長崎 工場移転に伴う特別利益の発生

- 不動産交換契約締結日 : 2021年4月28日
- 交換差益 : 1,888百万円

2022年3月期 業績見込み



(百万円)

	2021年3月期	2022年3月期			対前年比	
	通期	上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	143,268	72,000	82,000	154,000	10,731	7.5%
CN事業	23,933	10,000	14,000	24,000	66	0.3%
EC事業	119,334	62,000	68,000	130,000	10,665	8.9%
経常利益 (利益率)	4,625 (3.2%)	1,500 (2.1%)	3,600 (4.4%)	5,100 (3.3%)	474	10.3%
当期純利益 (利益率)	3,143 (2.2%)	2,000 (2.8%)	2,400 (2.9%)	4,400 (2.9%)	1,256	40.0%

当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております

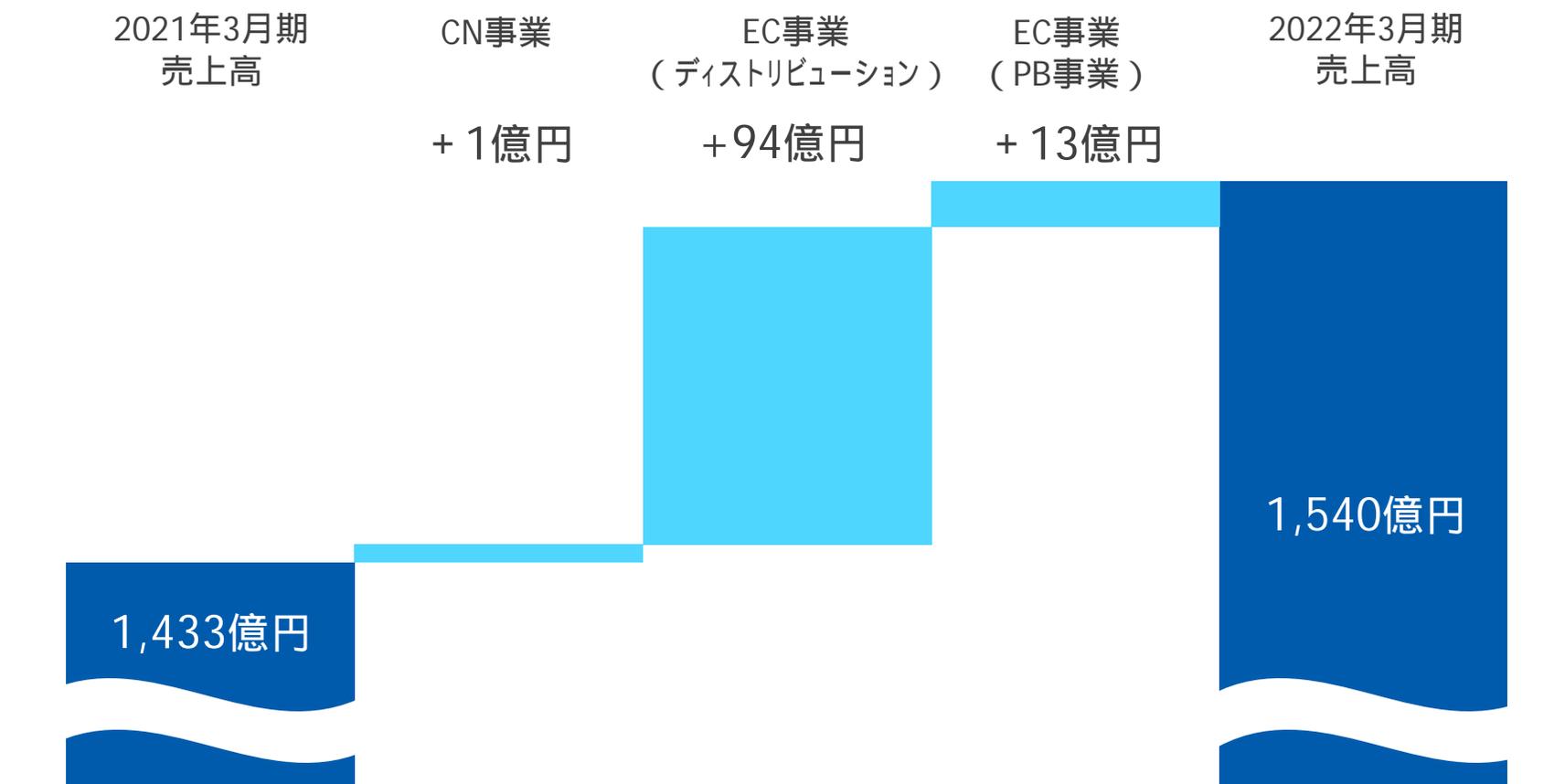
2022年3月期 事業計画前提



■ 全社

- 新型コロナウイルス感染による影響
 - ワクチン接種が進むも 鎮静化には時間を要す
 - 一方多くの製造業では 先行して回復
- 米中間の対立（先鋭化と長期化）
 - 半導体やIT機器の サプライチェーンをめぐる競争が激化
- 半導体の需給状況
 - 上期中は逼迫感が続くが 下期より改善
- データ通信量の増大
 - DX化の進展などにより 通信量の増加傾向が続く

業績見込み 売上高増減



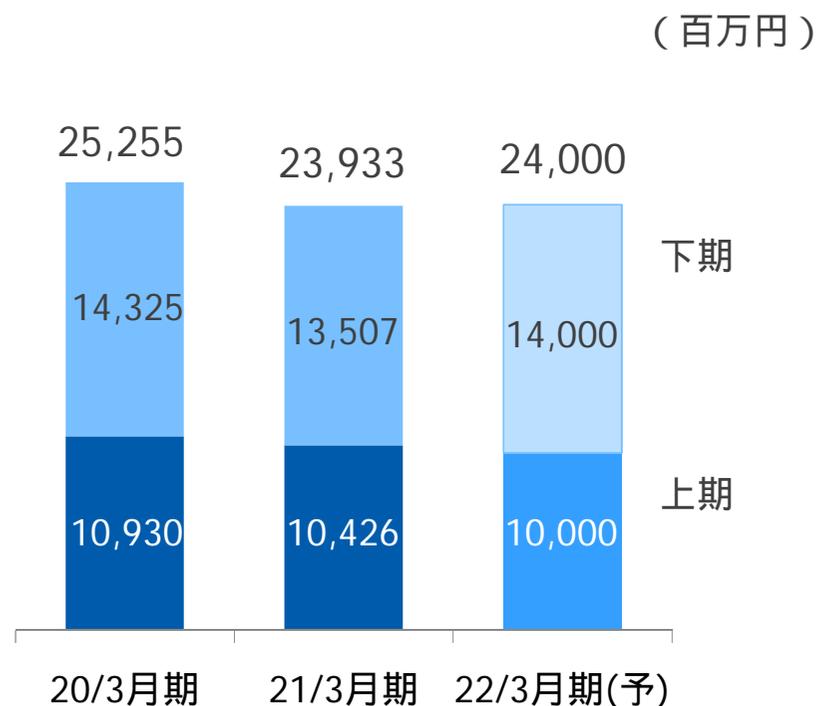
※金額は四捨五入で記載しております

2022年3月期 CN事業計画 (1/3)



売上高

重点項目

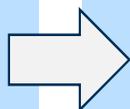


- ストレージ・ネットワーク製品の販売促進
- サービスビジネスの拡大（保守・監視）
- セキュリティ製品の販売促進
- A I 製品のマーケティング強化

ストレージ・ネットワーク製品の販売促進

データ通信量の増大

- テレワークの普及
- クラウドサービス拡大
- EC・通販市場の拡大
- 5Gサービスの本格開始



ITインフラの拡大

- ストレージ
- ネットワーク
- サーバー

販売促進 製品

オールフラッシュストレージ



ネットワーク関連製品



AI製品のマーケティング強化

AIラボの稼働開始

- 技術開発 受注体制の強化



製造工程における検査や予知保全

AIプラットフォーム

NVIDIA社 「NVIDIA DGX システム」

大規模AIシステムの構築

超高速ディープラーニングシステム

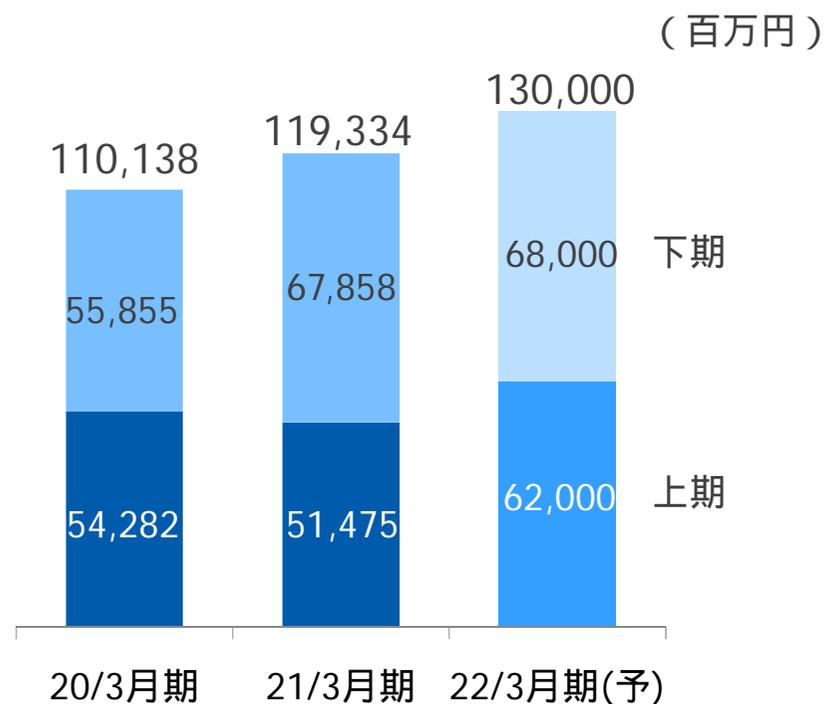
Cerebras System社 「CS-1」

2022年3月期 EC事業計画 (1/2)



売上高

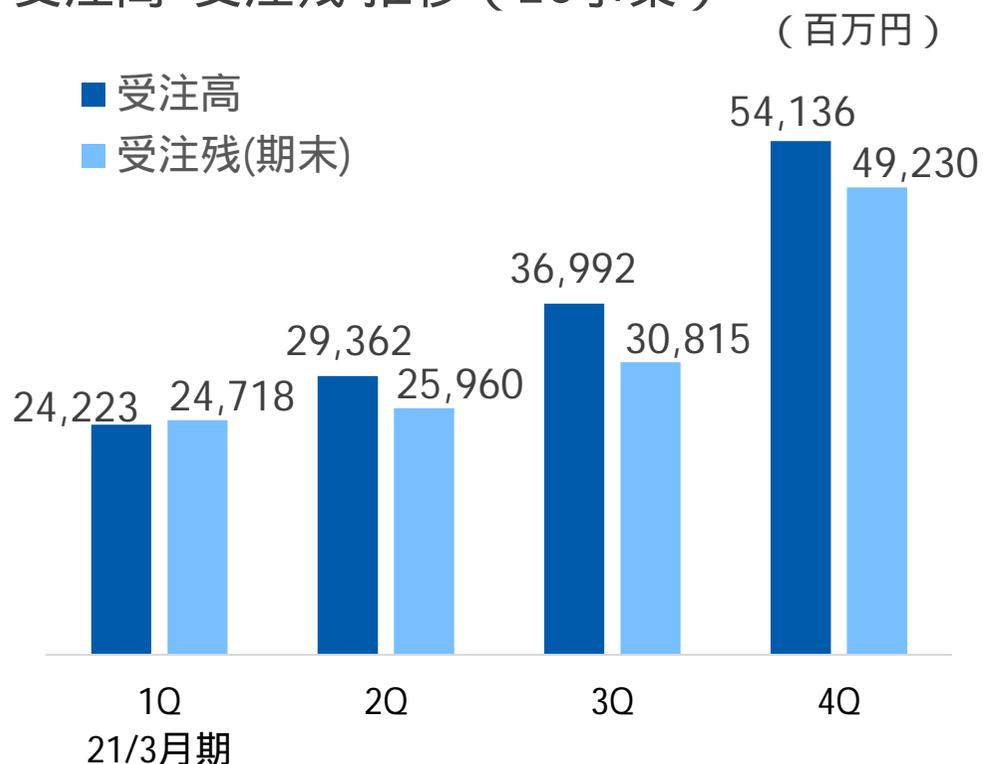
重点項目



- 産業機器及び車載機器の販売促進
- 供給問題に対する納期対応
- クラウド（課金型）ビジネスの推進

半導体の需給状況と見通し

受注高・受注残 推移 (EC事業)



21年3月期の状況

- 受注高・受注残 共に4Qにかけて大きく拡大

22年3月期の見通し

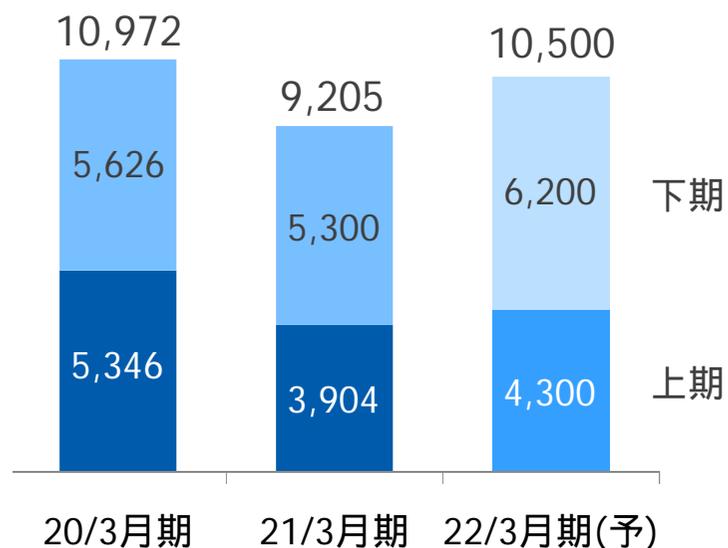
- 上期中は 逼迫感が継続
- 供給サイドの調整などが進み
下期以降に徐々に落ち着きを取り戻す

2022年3月期 PB事業計画 (1/3)



売上高

(百万円)



重点項目

- 共通
半導体装置 産業機器 関連需要の取込み
- インレビウム (TED)
自社ブランド製品の開発及び販売の強化
- TED長崎
新工場への速やかな移行
- ファースト
パネル検査需要の取込み

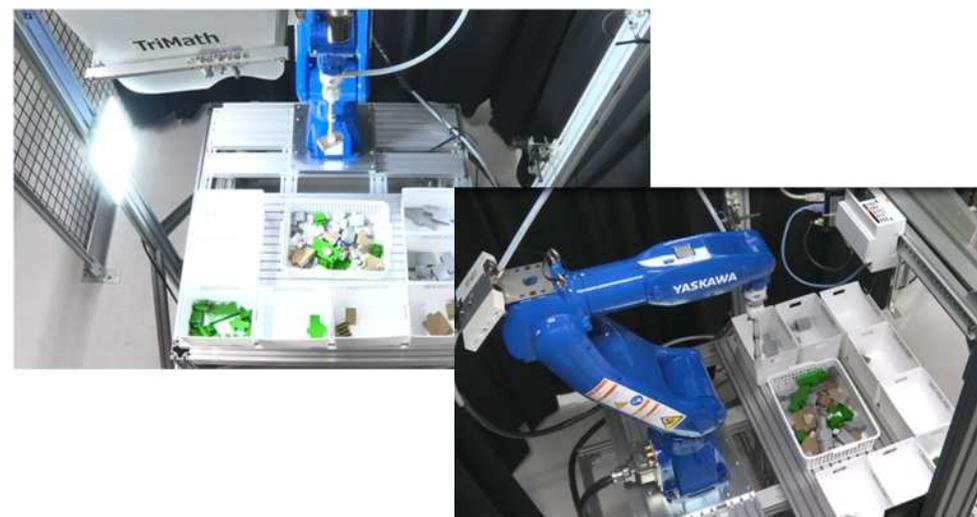
自社ブランド製品の開発・販売の強化

マクロ検査装置 「RAYSENS」



- 納入実績の蓄積
- 検査対象ウエハの大口径化(8インチ)

3Dビジョンロボットシステム 「TriMath」



- ロボットビジョンの智能化の推進

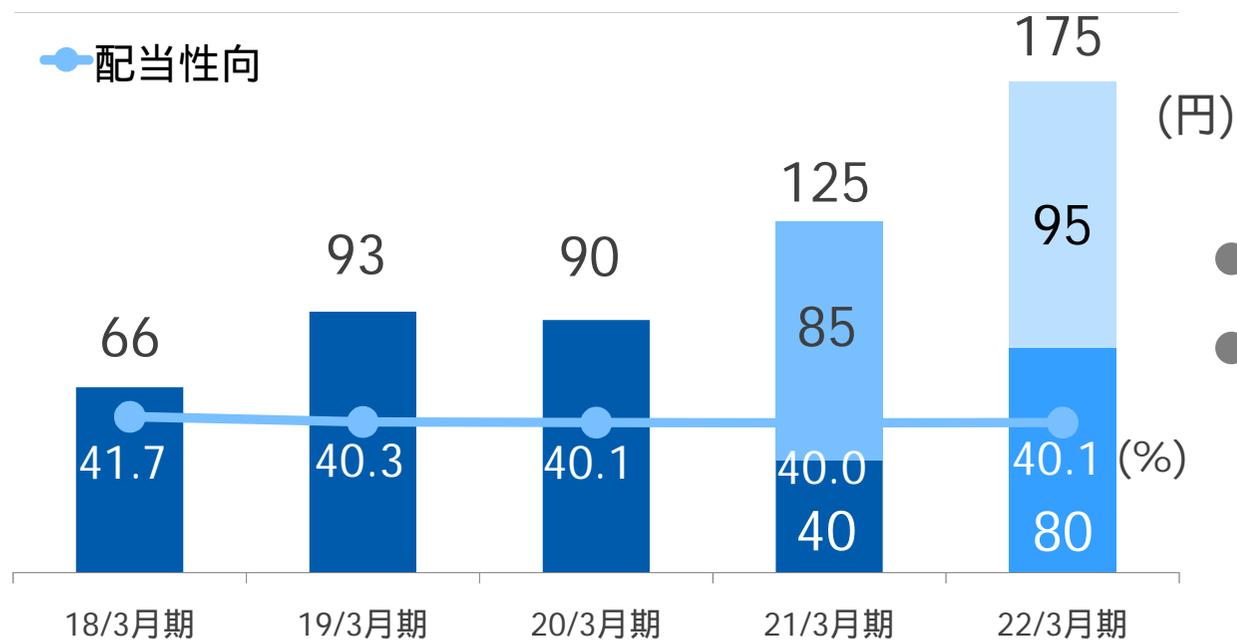
TED長崎新工場

- 将来的なライン拡張スペースの確保
 - 敷地面積 8,886 → 13,088 m²
 - 延床面積 3,642 → 6,060 m²
- 生産性の向上
 - 生産工程の見える化
 - トレーサビリティ管理



1株当たり配当金

	2020年3月期	2021年3月期 (当初予定)	2021年3月期	2022年3月期
中間	40円	40円	40円	(予定) 80円
期末	50円	68円	85円	(予定) 95円



- 連結配当性向 40%を目安
- 安定的・継続的な配当の実施

The logo features a stylized 'C' composed of three curved segments: a blue segment on the left, a green segment at the top, and a red segment at the bottom. To the right of this 'C' is the text 'onnect Beyond' in a bold, black, sans-serif font.

本資料に関する注意事項

本資料で述べられている将来に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な要因により、今後の業績見通しが本資料と異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

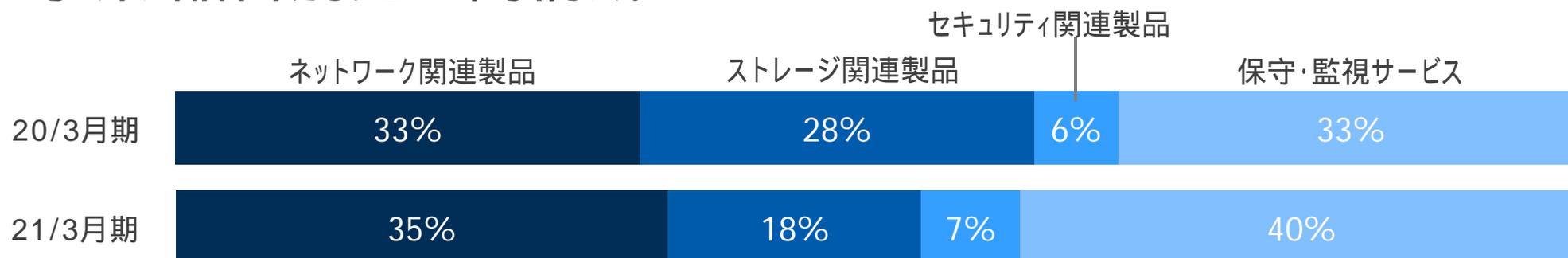
また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

本資料に掲載された会社名、製品名、サービス名ならびにロゴは、各社の商標または登録商標です。



補足資料

CN事業 品目別売上高構成



品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
ネットワーク関連製品	1.2%	データセンター・クラウド事業者向け機器販売堅調	F5ネットワークス アリスタネットワークス エクストリームネットワークス
ストレージ関連製品	38.0%	代理店契約解消によりシステムインテグレーター向けSANスイッチ減少 データセンター向けフラッシュストレージ増加	ピュアストレージ デルテクノロジーズ ブロードコム
セキュリティ関連製品	12.3%	リモートアクセス、クラウド向けセキュリティ需要増加	ニュータニックス ネットスコープ
保守・監視サービス	12.5%	エンタープライズ向け、通信事業者向けに機器保守増加	TED

CN事業 品目別売上高構成（旧分類）



品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
ネットワーク 関連製品	4.4%	データセンター・クラウド事業者向け機器販売堅調 保守サービス好調	F5ネットワークス アリスタネットワークス インフォブロックス
ストレージ 関連製品	25.9%	代理店契約解消によりシステムインテグレーター向け SANスイッチ減少 データセンター向けフラッシュストレージ増加	ピュアストレージ デルテクノロジーズ ブロードコム
ソフトウェア他	25.2%	リモートアクセス、クラウド向けセキュリティ需要増加	ニュータニックス ネットスコープ

EC事業 品目別売上高構成



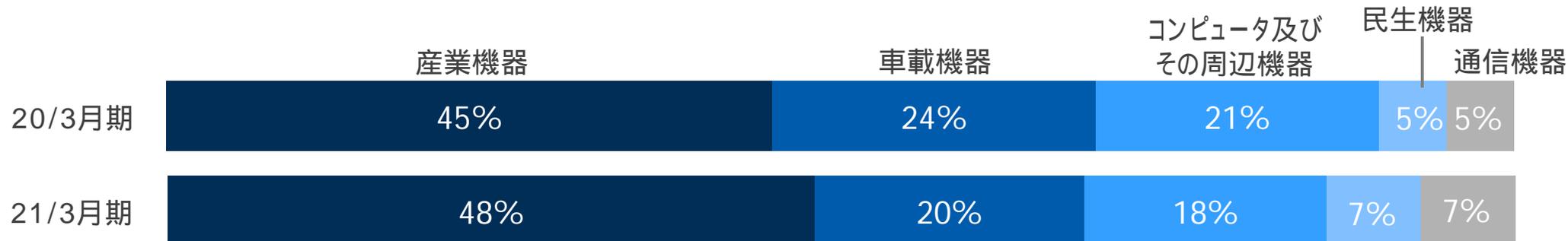
品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
アナログIC	38.8%	産業機器大幅増加 民生増加 車載減少	TI / NXP
プロセッサ	29.9%	産業機器 コンピュータ周辺機器 基地局増加	NXP/ TI / インテル / サイプレス(スパンション含む)
ロジックIC	3.9%	PC プロジェクタ MFP 減少 産業機器増加	TI / NXP / ラティス / サイプレス / イケリタス / ソシネクスト / ピケルワークス
メモリIC	11.7%	車載増加 産業機器増加	サイプレス(スパンション含む)
ボード・電子部品他	29.2%	産業機器 車載 減少 代理店契約解消	ウイスタンデジタル / ブロードコム / NXP / インテル / コーセル / ハギワラソリューションズ
ソフトウェア・サービス	3.5%	POS減少 クラウドビジネス増加	マイクロソフト / マカフィー
PB	16.2%	設計・量産受託サービス TED長崎 ファースト減少	TED / TED長崎 / ファースト

EC事業 品目別売上高構成（旧分類）



品目	増減率	主な要因	主な仕入れ先
汎用IC	39.5%	産業機器大幅増加 車載減少	TI / NXP / マクスリニア
プロセッサ	30.0%	産業機器 コンピュータ周辺機器 基地局増加	NXP/ TI / インテル / サイプレス(スパンション含む)
専用IC	5.8%	PC プロジェクタ MFP 民生機器減少	TI / NXP / エセリタス / ピクセルワークス / サイプレス / インビーム
メモリIC	11.7%	車載増加 産業機器増加	サイプレス(スパンション含む)
カスタムIC	15.3%	産業機器減少	ラティス / ソシオネクスト / インビーム
光学部品	70.1%	代理店契約解消 産業機器 車載減少	ブロードコム
ソフトウェア・ボード 他	4.3%	POS減少 クラウドビジネス増加	マイクロソフト / ウェスタンデジタル / PFU / インテル / インビーム

EC事業 用途別売上高構成



用途	増減率	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	16.2%	医療機器 放送機器 監視カメラ FA機器 計測器 工業用ロボット 工作機械 半導体製造装置 インバータ	商権拡大によりアナログ IC プロセッサ増加 代理店契約解消により光学部品減少
車載機器	12.9%	ナビゲーション カーオーディオ ボディ系	アナログ IC減少 光学部品減少 商権拡大によりプロセッサメモリ増加
コンピュータ及びその周辺機器	6.1%	複合プリンタ プロジェクタ OA機器 ストレージ サーバ PC及び付属機器 POS	サーバ向けプロセッサ増加 POS向けソフトウェア減少 プロジェクタ MFP向けロジックIC減少
民生機器	60.6%	デジタルカメラ デジタルビデオカメラ TV DVD AV機器 家庭用ゲーム リモコン 白物家電	ゲーム機器向けアナログ IC増加
通信機器	55.8%	ルータ 伝送装置 基地局	通信基地局向けプロセッサアナログ IC 増加

品目



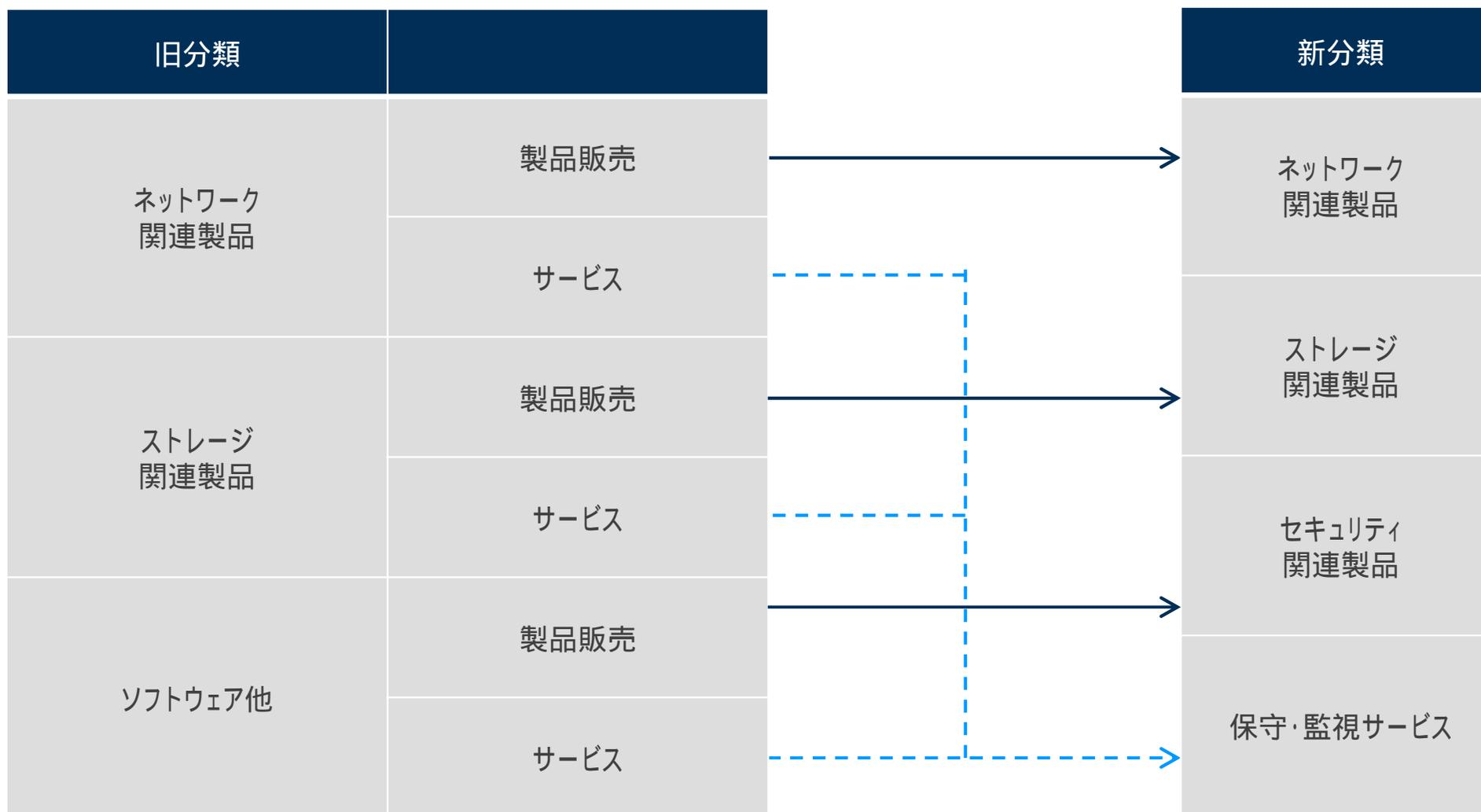
	品目	主な製品	機能
CN事業	ネットワーク関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ	インターネットの接続負荷の分散 スイッチングハブ
	ストレージ関連製品	フラッシュストレージ	大容量データに高速に接続、記憶する
	セキュリティ関連製品	エンドポイント ネットワーク クラウド	コンピュータシステム、ネットワーク、データなどを、攻撃や 破損、不正アクセスから保護する
	保守・監視サービス	機器の保守サービス セキュリティ監視サービス	
EC事業	アナログIC	アナログIC	色々な用途に共通に使用されるIC
	プロセッサ	CPU DSP	電子機器の頭脳 演算機能・制御機能
	ロジックIC	画像処理用IC 通信・ネットワーク用IC ASIC PLD	論理回路をパッケージ化したIC 特定用途向けに作ら れた専用IC お客様の仕様に応じて作られる固有IC
	メモリIC	SRAM FRAM MRAM フラッシュメモリ	記憶用IC 書込み読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
	ボード・電子部品他	ボード 電源 光学部品	プリント配線基板上にIC 電源 コネクタなどの部品を 実装した製品（ボード）
	ソフトウェア・サービス	ソフトウェア クラウドサービス	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア サブスクリプションでのサービス提供
	PB	設計・量産受託サービス 自社ブランド製品	お客様の仕様に応じた基板の設計・開発・量産 製造業向け機器

品目（旧分類）



	品目	主な製品	機能
CN事業	ネットワーク関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ	インターネットの接続負荷の分散 スイッチングハブ
	ストレージ関連製品	SANスイッチ フラッシュストレージ	大容量データに高速に接続、記憶する
	ソフトウェア他	仮想化基盤プラットフォーム クラウドセキュリティ	データベース管理、クラウド環境の管理
EC事業	汎用IC	アナログIC ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
	プロセッサ	CPU DSP	電子機器の頭脳 演算機能・制御機能
	専用IC	画像処理用IC 通信・ネットワーク用IC	特定用途向けに作られた専用IC
	メモリIC	SRAM FRAM MRAM フラッシュメモリ	記憶用IC 書き込み読み出しが可能なものや 読み出しのみのものがある
	カスタムIC	ASIC PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
	光学部品	LED フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
	ソフトウェア・ ボード他	ソフトウェア ボード 電源 コネクタ	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア プリント配線基板上にIC 電源 コネクタなどの部品を 実装した製品（ボード）

CN事業 品目新旧対応表



EC事業 品目新旧対応表

